

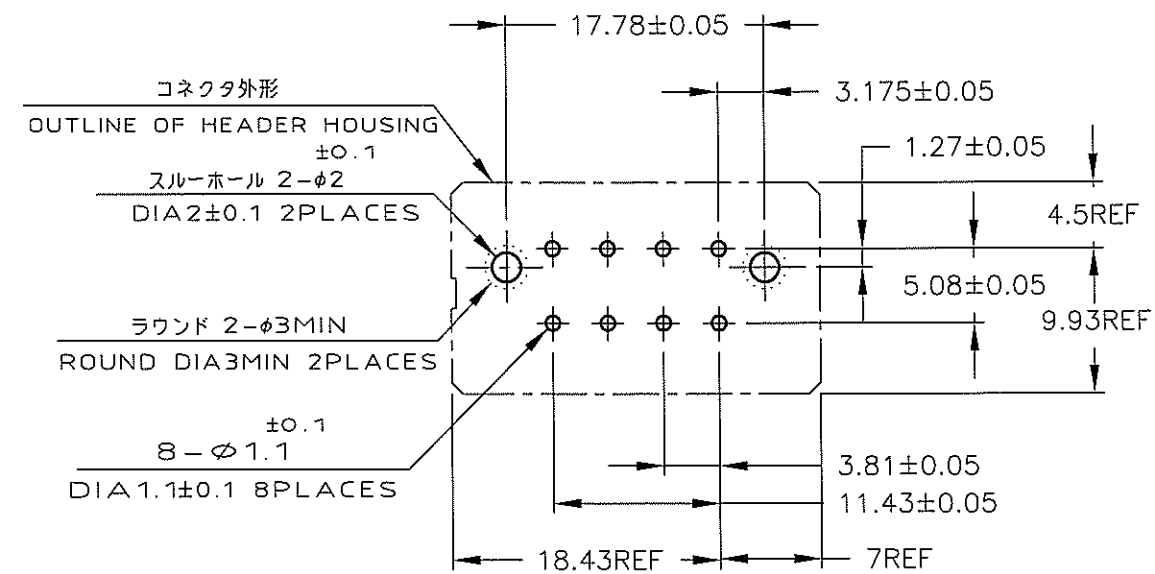
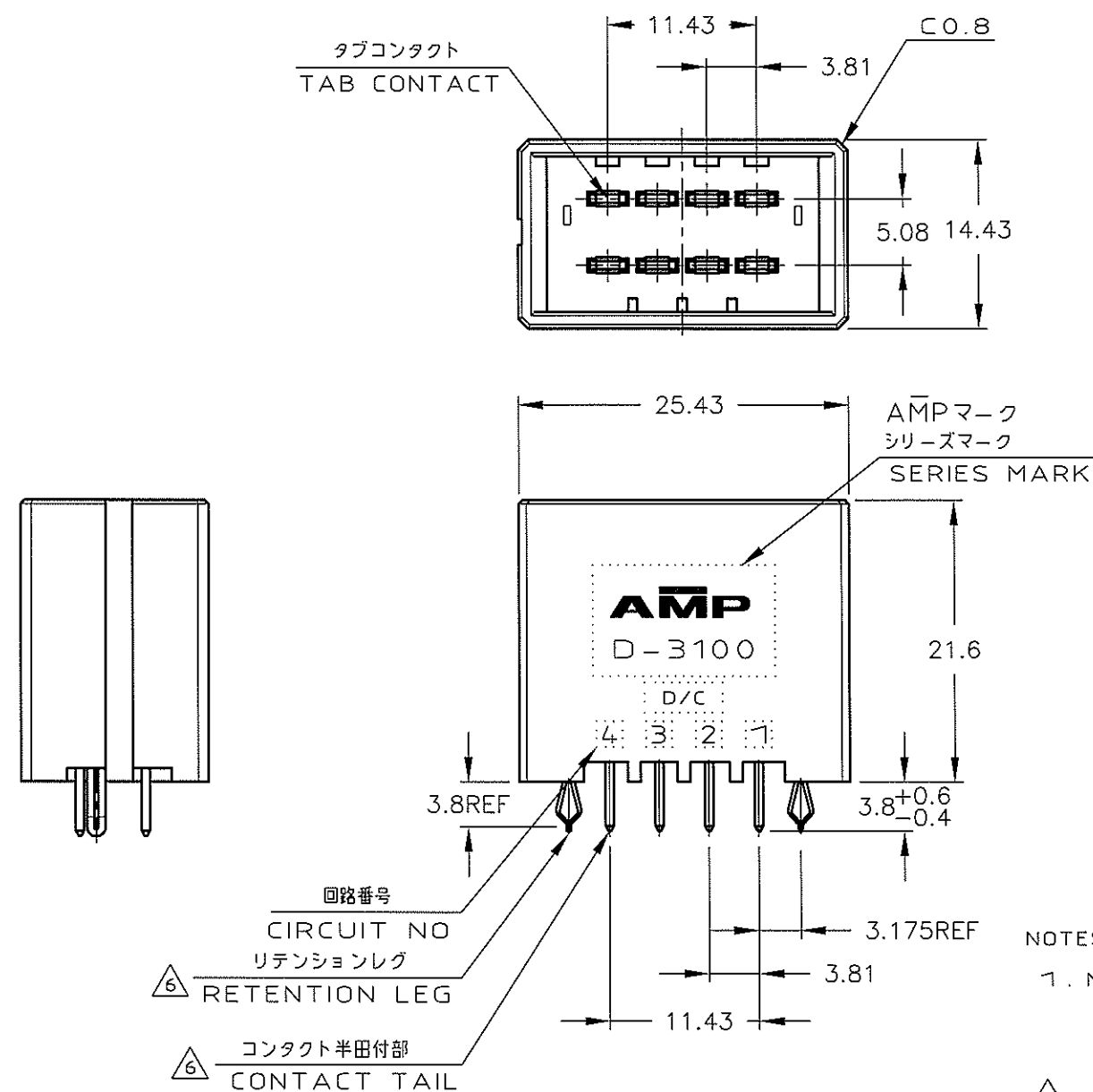
NUMBER 1903601



METRIC

DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

AMP-J
REV.10/83

推奨基板取付け寸法
PC 基板厚: 1.6±0.1
(非累積公差)
(コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN
PC BOARD THICKNESS: 1.6±0.1
(NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
(CONNECTOR MOUNT SIDE)

NOTES

1. MATERIAL: HOUSING: GLASS FILLED THERMO PLASTIC, POLYESTER (94V-0), COLOR: BLACK
CONTACT: COPPER ALLOY
RETENTION LEG: COPPER ALLOY
2. FINISH (CONTACT AREA): 0.38μm MIN GOLD PLATING OVER NI PLATING
3. FINISH (CONTACT AREA): 0.76μm MIN GOLD PLATING OVER NI PLATING
4. FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL
5. FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL

注記

1. 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性
ポリエステル樹脂 (94V-0), 色: 黒
コンタクト: 銅合金
リテンションレグ: 銅合金
2. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.38μm MIN金めっき
3. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.76μm MIN金めっき
4. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 2.0 μm MINスズめっき
5. めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部: ニッケル下地の上にスズめっき

△6	△4	1903601-5
△6	△3	-
△6	△2	1903601-2
(FINISH)		製品番号 (PART NO.)

B	REVISED	ECR-06 022713	Y.Y	D.M	25SEP 2006
A	RELEASED		TS	DM	7MAR 2006
LTR	REVISION RECORD		DR	CHK	DATE

Copyright © 1994 AMP(Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED.						tyco Electronics		Tyco Electronics AMP K.K Kawasaki,Japan	
WIRE RANGE		INSULATION DIA		NAME					
mm ² (AWG -)		- mmφ		8 POS DOUBLE ROW VERTICAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC D-3100					
MATERIAL		FINISH		一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		SIZE	LOC	NUMBER	
SEE NOTE 注記参照		SEE NOTE 注記参照		10mm ±0.3 10mm 30mm ±0.4 30mm 100mm ±0.45 角 度 ±3°		A3	J	C-1903601	
DR. T.Sakamoto		DE.		SCALE		REV.		SHEET	
7MAR2006		7MAR2006		2-1		B		1 of 1	
CHK D.MITSUGI		APP D.MITSUGI							
7MAR2006		7MAR2006							

(CUSTOMER DRAWING) 顧客用図面